

2026年3月期  
**決算説明資料**

2026年5月15日  
**内外テック株式会社**  
(証券コード 3374)



2026年3月期  
**決算ハイライト**

# 本日のポイント

## POINT

# 1

2026年3月期実績  
AI関連を中心に市場の回復が見られ、4Qから急速に回復。  
期前半の顧客の在庫調整の影響により、通期では減収減益。

売上高 **32,614**百万円  
(前期比▲7.7%)

営業利益 **1,402**百万円  
(前期比▲9.6%)

親会社株主に帰属する当期純利益 **971**百万円  
(前期比▲7.4%)

## POINT

# 2

2027年3月期予想  
増収増益を見込む。  
増産及び成長戦略に基づく先行投資により利益は微増。

売上高 **40,600**百万円  
(前期比24.5%)

営業利益 **1,500**百万円  
(前期比6.9%)

親会社株主に帰属する当期純利益 **1,000**百万円  
(前期比2.9%)

## POINT

# 3

中期経営計画「MIRAI 2026」の基本方針を継承し、新たに中期経営計画「MIRAI 2030」を策定。フィジカルAI戦略を軸に中長期的な成長を目指す。(詳細は中期経営計画参照)

2031年3月期 (最終年度)

売上高 **50,000**百万円

営業利益率 **7.0%**

ROE **12.5%**

配当性向 **30%** DOE **3%**



# 2026年3月期 連結業績・事業概況

## 2026年3月期 業績 (2025年4月～2026年3月)

- ・ 市場の回復が見られたことから受託製造事業は堅調な受注を確保  
販売事業は顧客の在庫調整の影響を受け、受注が3Q後半から回復するも、通期業績は減収減益
- ・ 25年11月12日公表の修正予想から大きく上回る結果

### 決算実績

(百万円)	2025年3月期			2026年3月期			
	実績	前期比	構成比	実績	前期比	構成比	修正予想 (25.11.12)
売上高	35,337	▲9.4%	100.0	<b>32,614</b>	<b>▲7.7%</b>	100.0	<b>29,500</b>
売上原価	30,717	▲12.1%	86.9	<b>28,173</b>	<b>▲8.3%</b>	86.4	—
販管費	3,068	8.4%	8.7	<b>3,038</b>	<b>▲1.0%</b>	9.3	—
営業利益	1,552	27.4%	4.4	<b>1,402</b>	<b>▲9.6%</b>	4.3	<b>810</b>
経常利益	1,525	28.3%	4.3	<b>1,389</b>	<b>▲9.0%</b>	4.3	<b>780</b>
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,049	23.7%	3.0	<b>971</b>	<b>▲7.4%</b>	3.0	<b>380</b>

# 売上高・営業利益（四半期ベース）の推移

- ・通期では減収も、3Q後半から受注が急激に回復

## 売上高

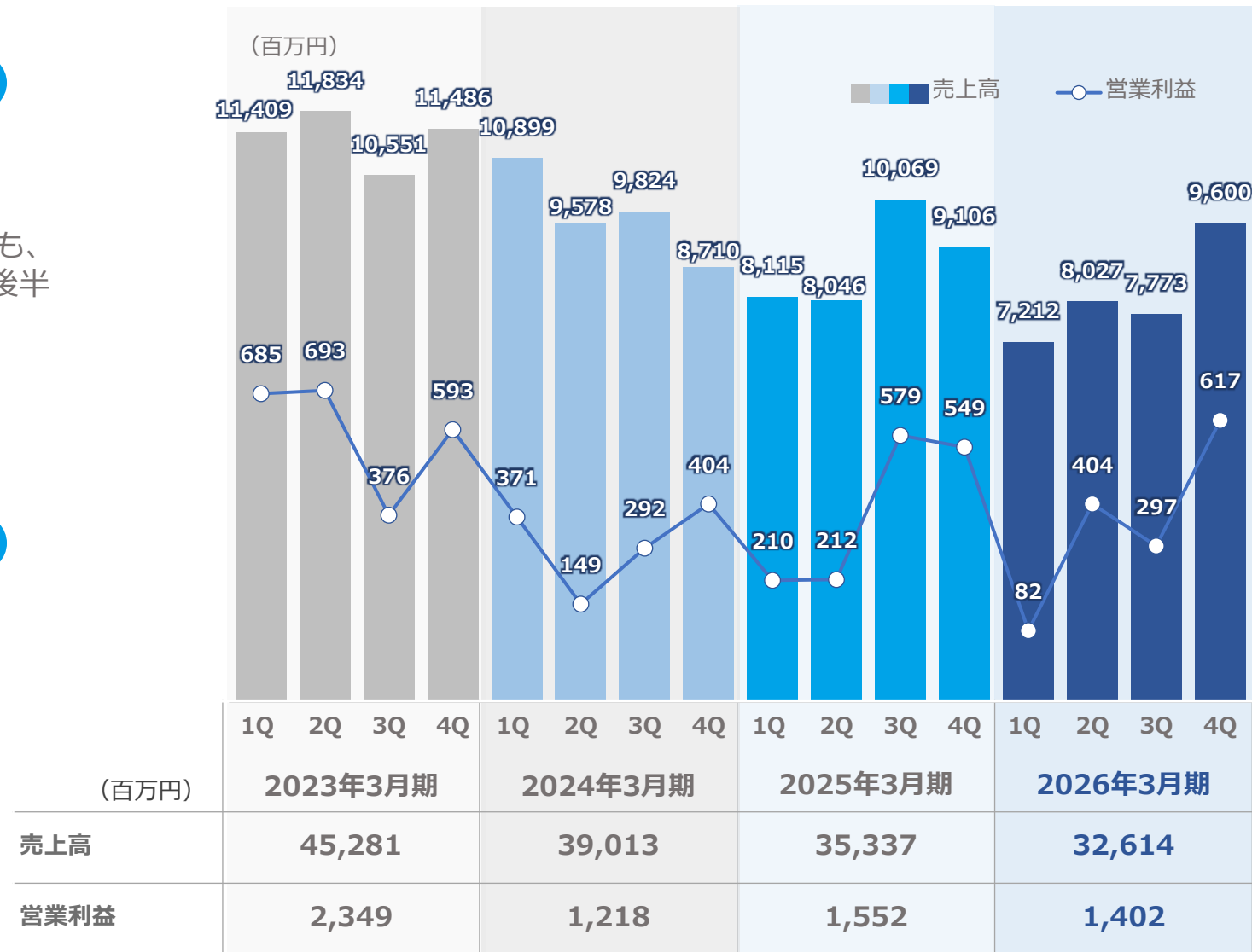
**32,614**百万円（前期比▲7.7%）

- 販売事業における在庫調整の影響を受け通期では減収も、市場の回復を背景に顧客の在庫調整の解消が進み3Q後半から急激に受注が回復

## 営業利益

**1,402**百万円（前期比▲9.6%）

- 通期では減益も、4Qに利益は急回復



# 売上総利益率・販管費（四半期ベース）の推移

- ・売上総利益率は上昇
- ・販管費抑制するも、販管費比率は売上高の減少により上昇

## 売上総利益率

**13.6%**（前期比+0.5ポイント）

- 販売価格の転嫁のほか、在庫販売が進み改善
- 4Qは仕入先からの販売報奨金により大幅に上昇

## 販売管理費

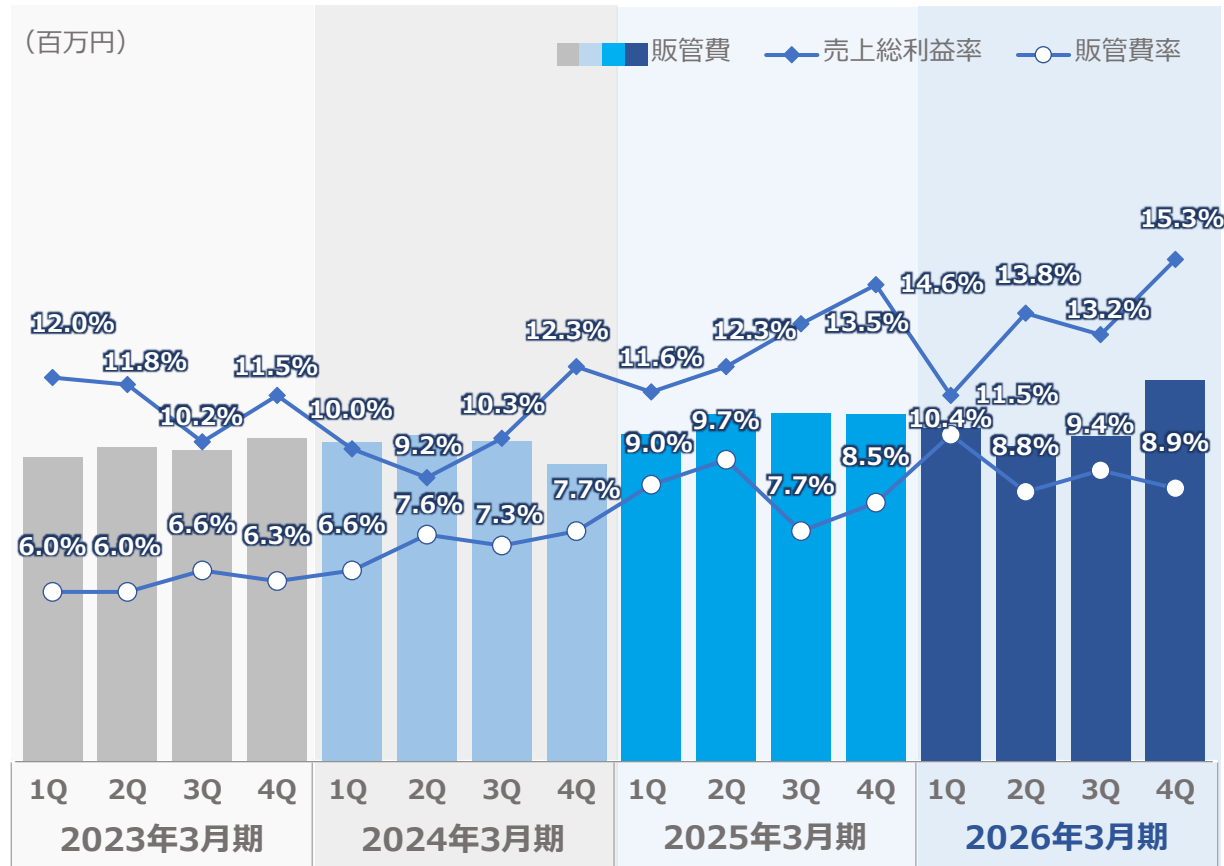
**3,038百万円**（前期比▲1.0%）

- 2Q・3Qを中心に販管費を抑制
- 今後の成長のための人材開発投資・研究開発投資は引上げ

## 販売管理費率

**9.3%**（前期比+0.6ポイント）

- 2Q以降販管費の抑制を行うも、通期では減収及び先行投資の影響により上昇



(百万円)	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
売上総利益率	11.4%	10.4%	13.1%	13.6%
販管費	2,809	2,830	3,068	3,038
販管費率	6.2%	7.3%	8.7%	9.3%

# セグメント別概況 販売事業

- ・ 3Q後半から受注が急速に改善するも通期では減収
- ・ 利益率の改善が寄与し増益

## セグメント売上高

**28,436百万円** (前期比▲9.1%)

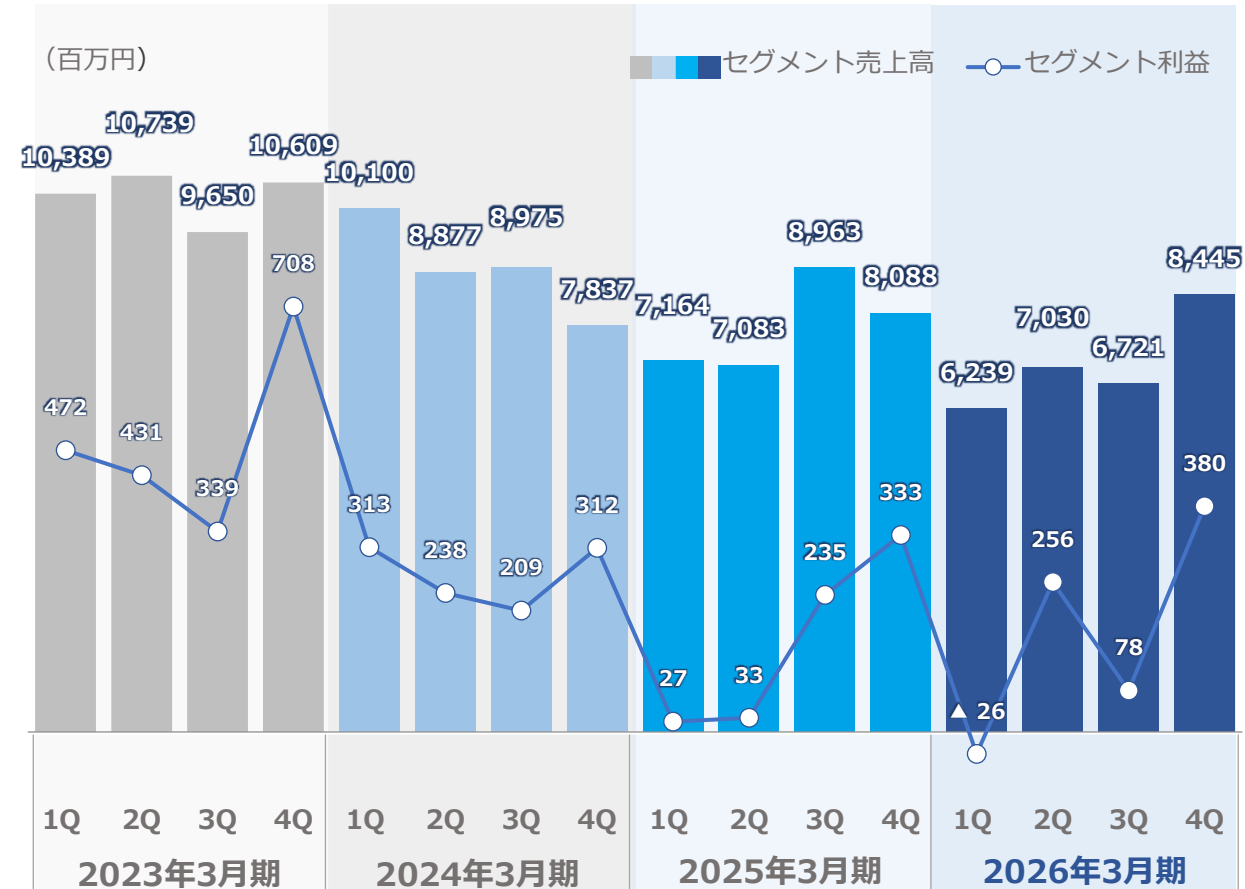
- 長期化する顧客の在庫調整等による影響から3Qまで低迷、3Q後半に受注が急速に改善するも、通期では減収

## セグメント利益

**689百万円** (前期比+9.3%)

- 売上高は減少するも、仕入原価増加に係る価格転嫁が進み売上総利益は増加
- 売上総利益の増加に加え、人材開発投資・研究開発投資を継続するも、その他の費用を抑制し増益
- 4Qは、主要仕入先からの報奨金が寄与

(注) セグメント売上高及びセグメント利益は、連結調整前の数値となっております



(百万円)	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
セグメント売上高	41,388	35,791	31,300	28,436
セグメント利益	1,951	1,072	630	689
セグメント利益率	4.7%	3.0%	2.0%	2.4%

# セグメント別概況 受託製造事業

- ・ 主要顧客からの受注が堅調に推移し増収
- ・ 成長戦略にかかるメンテナンスサポート人材の獲得・品質向上のための人材投資により減益

## セグメント売上高

**6,527百万円** (前期比+4.1%)

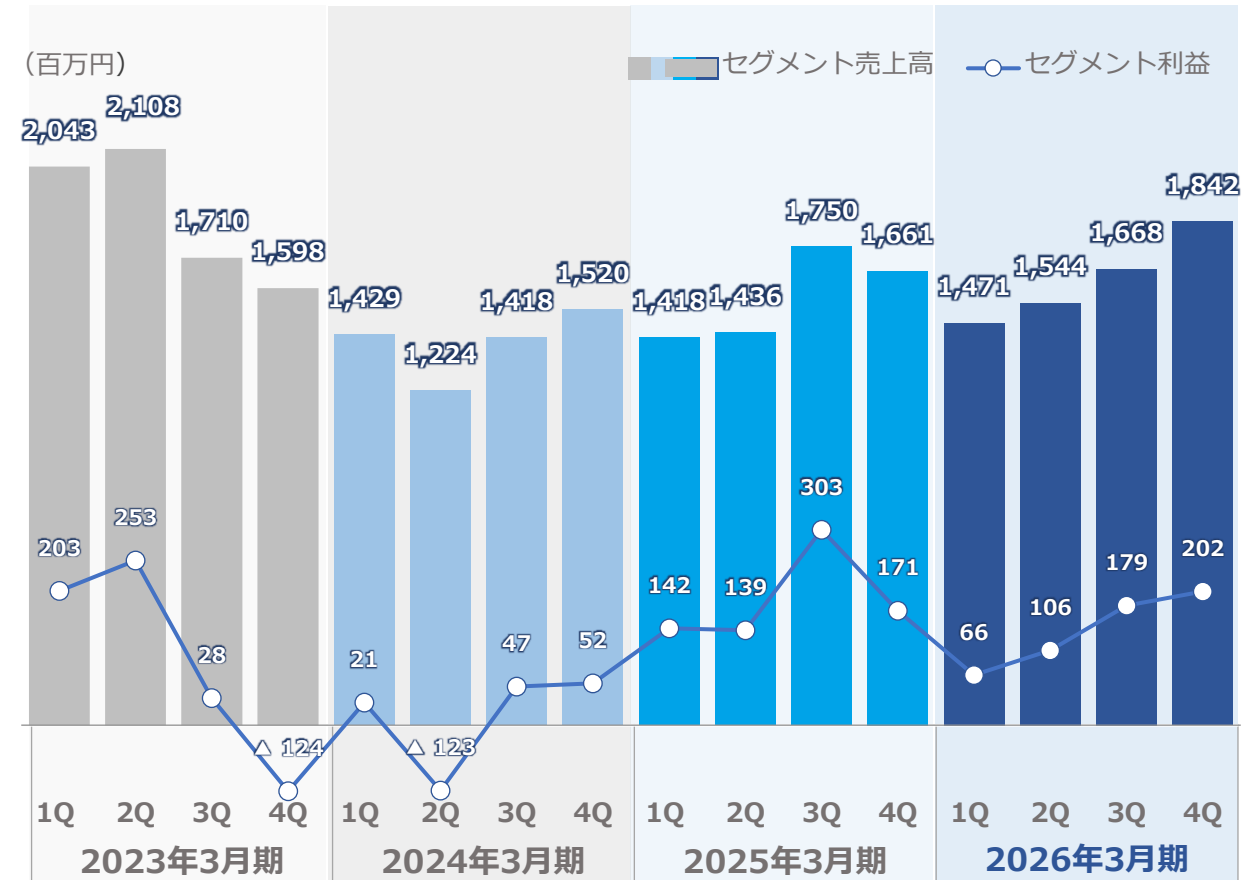
- 半導体市場の回復を受けて主要顧客からの受託製造の受注増加や、メンテナンスサポートの堅調な受注により増収
- 25.3期より実施のグループ効率化推進策（資材調達／物流統合）に伴い純額表示（会計処理）を実施。実質売上では過去最高を2期連続更新。

## セグメント利益

**555百万円** (前期比▲26.6%)

- 稼働率は改善するも、メンテナンスサポートのフィールドエンジニアや品質向上のための製造技術者の増員等に伴う労務費の増加により、減益

(注) セグメント売上高及びセグメント利益は、連結調整前の数値となっております

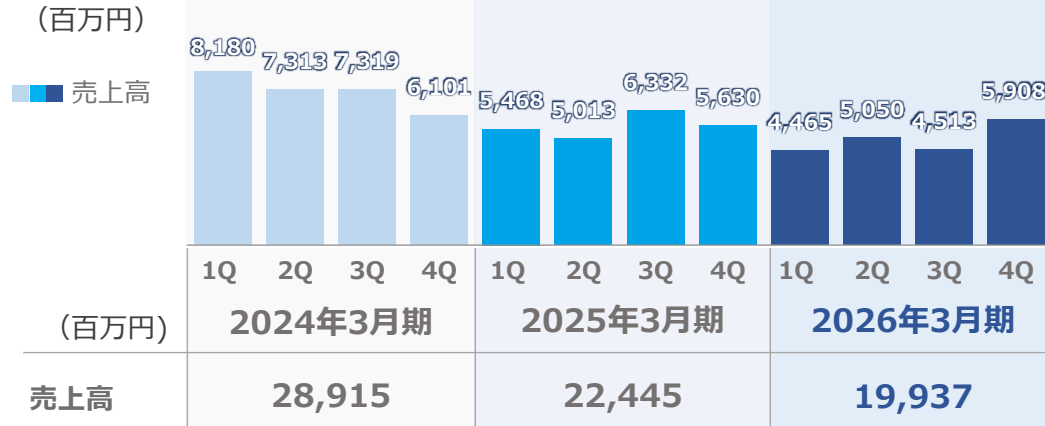


(百万円)	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
セグメント売上高	7,460	5,592	6,267	6,527
セグメント利益	361	▲2	755	555
セグメント利益率	4.8%	-	12.1%	8.5%

# 事業ポートフォリオ別売上高の推移

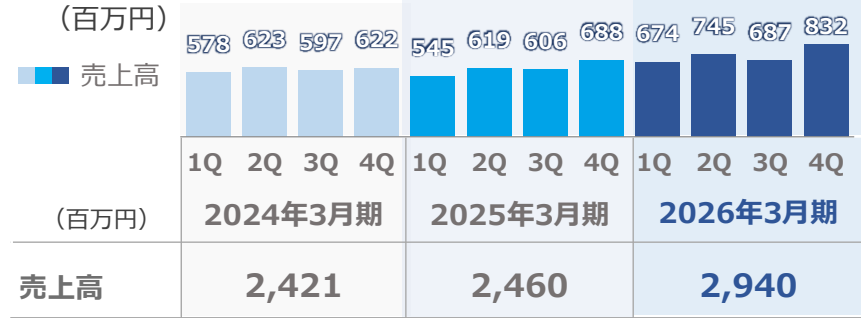
## サプライチェーン・ソリューション事業

- 4Qより回復するも、通期では顧客の在庫調整の影響を受け減収



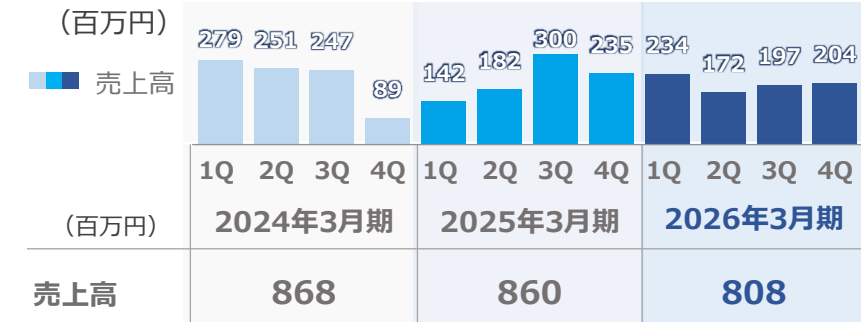
## フィールド・ソリューション事業

- 中期経営計画「MIRAI 2026」のフィールドエンジニア増強戦略による増員が寄与し増収



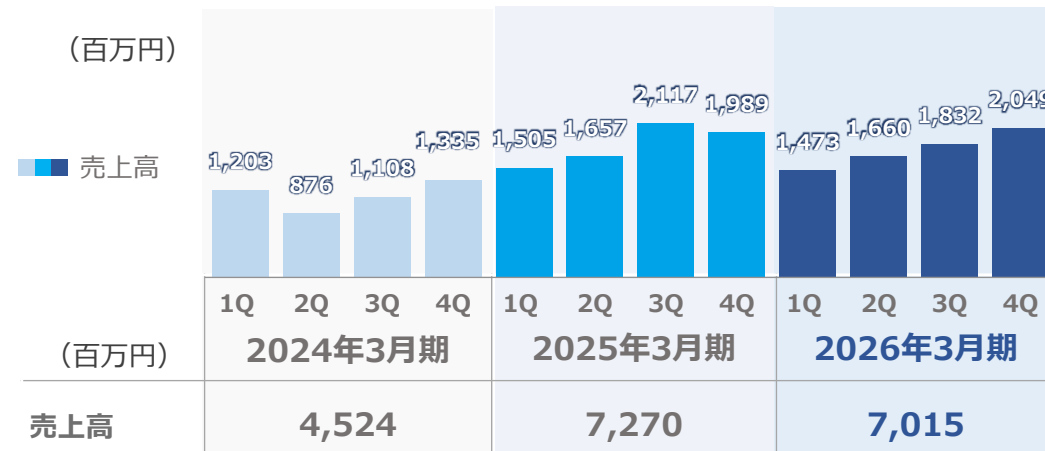
## テクニカル・ソリューション事業

- 今後の技術開発や新製品創出のための案件数は増加傾向にあるが、一部製品の受注が減少し減収



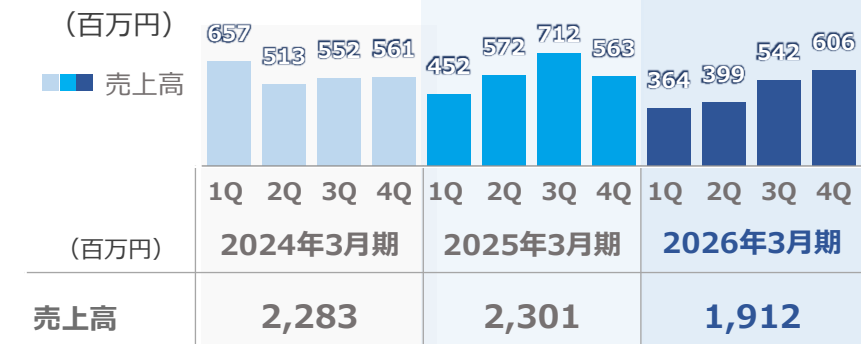
## マニュファクチャリング・ソリューション事業

- 受注は回復基調で推移するも、通期では減収



## プレジジョンマシニング・ソリューション事業

- 在庫調整の影響により一部製品が低迷し減収

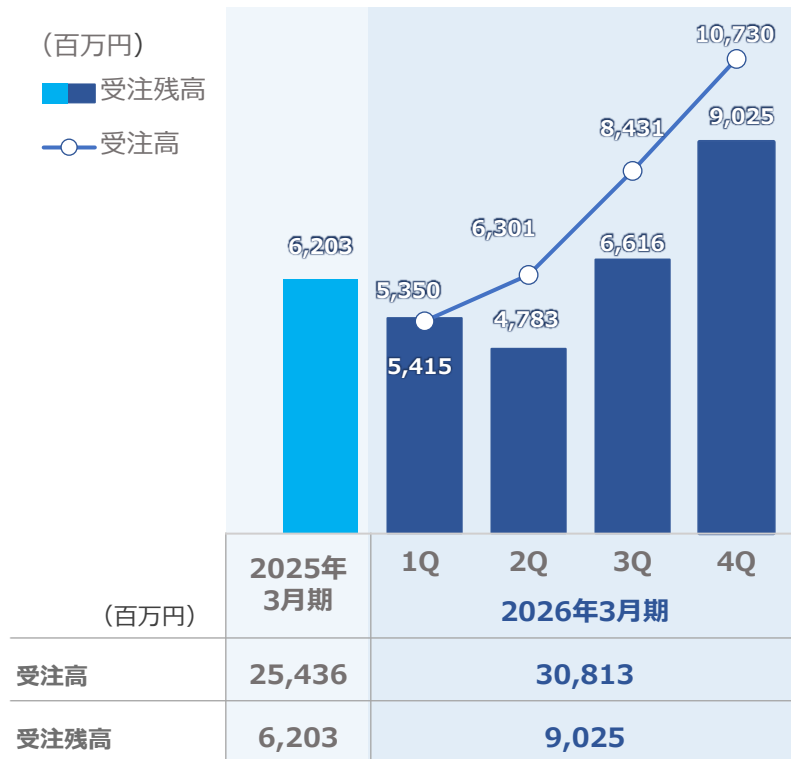


# 受注高・受注残高の推移

- ・ 受注高は増加傾向で推移。特に、販売事業は4Qに向けて急増
- ・ 期末の受注残高は高水準に

## 販売事業

受注残高 **9,025**百万円（前期比+45.5%）



## 受託製造事業

受注残高 **276**百万円（前期比+18.4%）

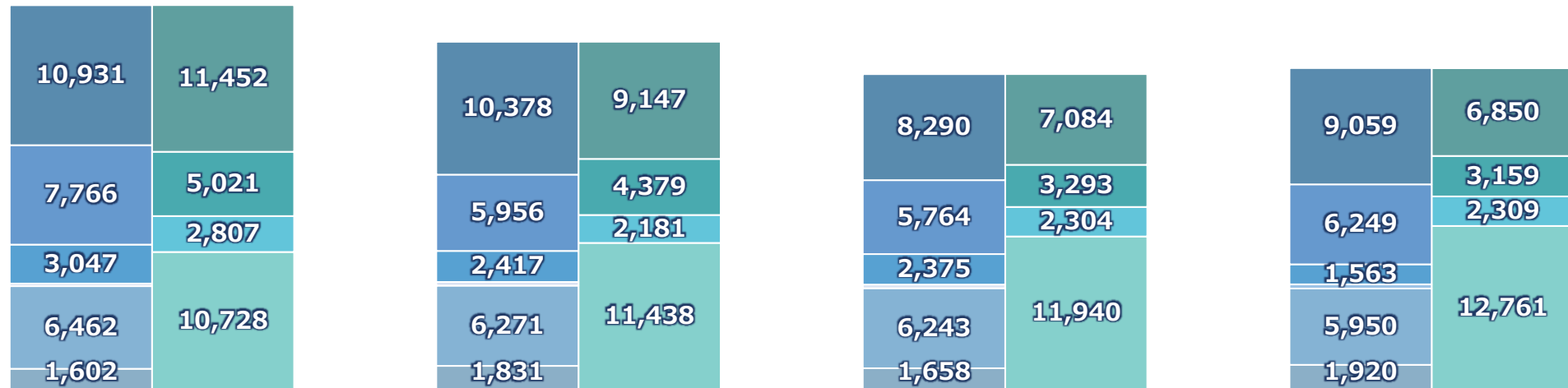
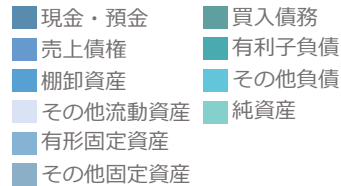


# 連結貸借対照表

- ・ 4Qの販売事業の急回復により売上債権が急増
- ・ 棚卸資産は、顧客への在庫納入が進み減少
- ・ 2026年1月施行の中小受託取引適正化法（取適法）に伴い支払条件を見直したことで、期末の買入債務は減少

## 連結貸借対照表

(百万円)



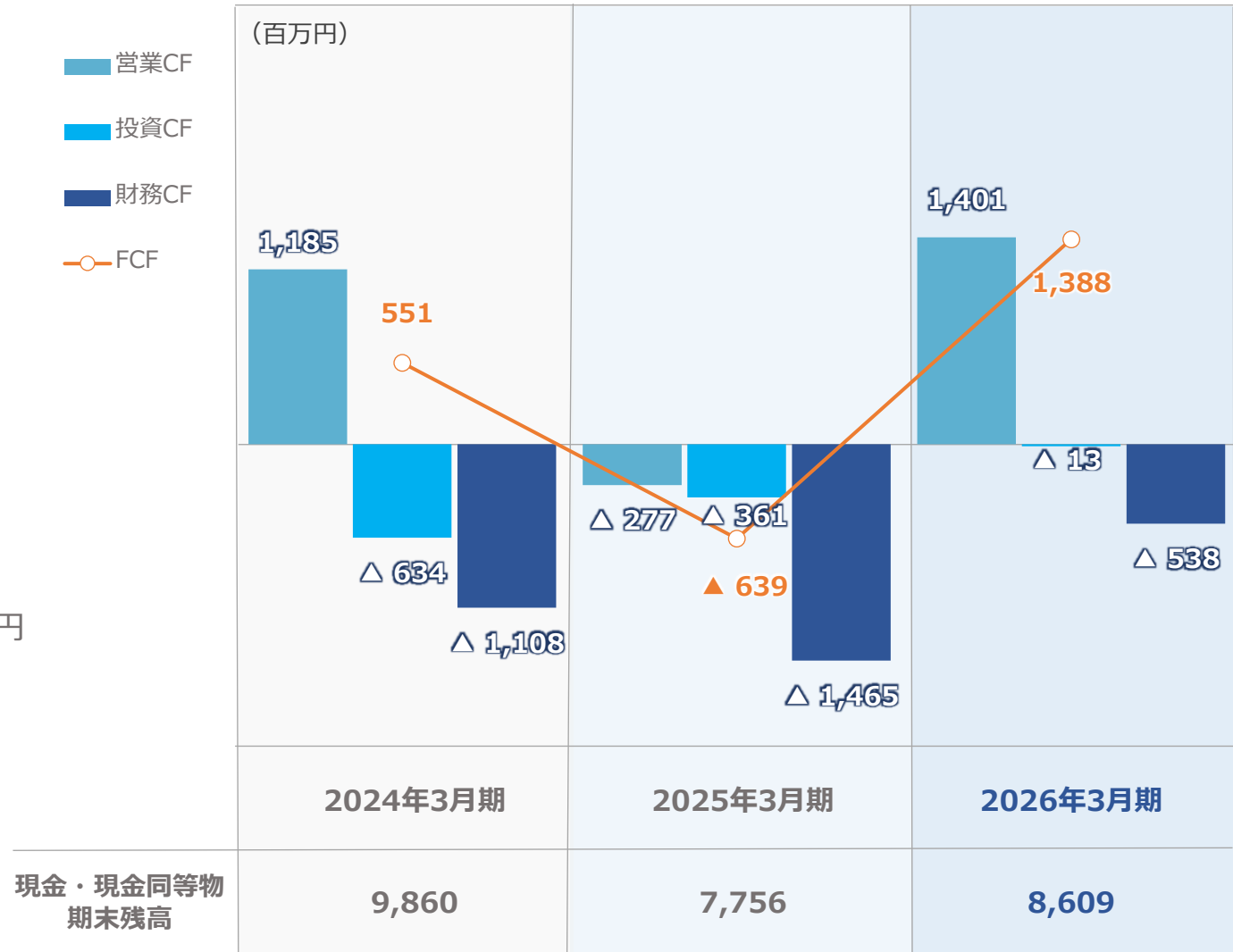
(百万円)	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
純資産	10,728	11,438	11,940	12,761
自己資本比率	35.7%	42.1%	48.5%	50.9%

# 連結キャッシュフロー

- 営業キャッシュフロー黒字に転換し、現金・現金同等物期末残高は増加

## キャッシュフロー計算書

- 税金等調整前当期純利益のほか、棚卸資産の圧縮により、営業キャッシュフローはプラスに転換
- 設備投資の一巡により、投資キャッシュフローはほぼゼロ
- 長期借入金の新規調達を行った一方、既存借入金の返済や配当金の支払等がこれを上回り、財務キャッシュフローはマイナス
- 現金及び現金同等物は、8億52百万円増加し、86億9百万円



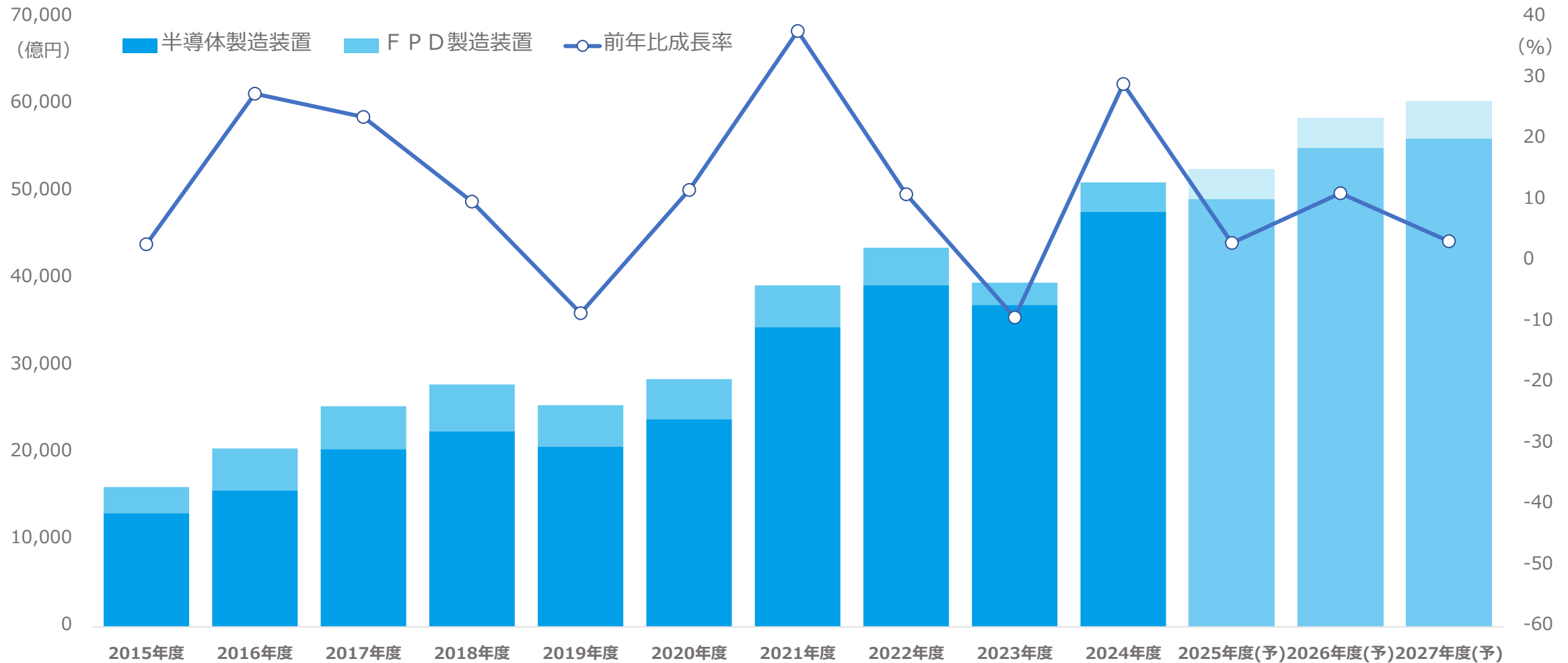


2027年3月期  
**連結業績予想**

# 半導体製造装置市場動向

- ・ A I 関連半導体の需要が牽引し、中長期的に拡大傾向

## 半導体・FPD装置 日本製装置販売高予想



出所：SEAJ 2026年1月15日発表資料を基に当社にて作成

## 2027年3月期 通期連結業績予想

- ・地政学リスクに伴う原材料価格の上昇や部材調達への影響等、足元の不透明感は増しているものの、半導体市場の回復に伴う顧客の在庫調整が解消・足元の受注残から増収を見込む
- ・各段階利益は、新中期経営計画「MIRAI 2030」に基づくAI関連を中心とした成長投資や増産対応に備えた先行投資から微増

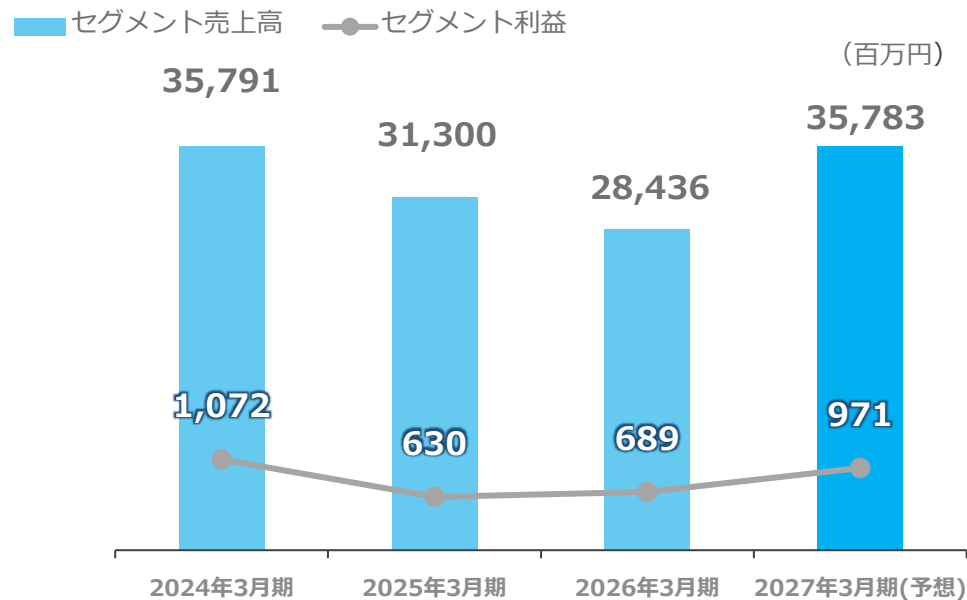
(百万円)	2026年3月期			2027年3月期				
	通期			通期			第2Q累計	
	実績	前期比	構成比	通期予想	前期比	構成比	中間予想	前年同期比
売上高	32,614	▲7.7%	100.0	<b>40,600</b>	<b>24.5%</b>	<b>100.0</b>	<b>19,000</b>	<b>24.7%</b>
営業利益	1,402	▲9.6%	4.3	<b>1,500</b>	<b>6.9%</b>	<b>3.7</b>	<b>552</b>	<b>13.2%</b>
経常利益	1,389	▲9.0%	4.3	<b>1,460</b>	<b>5.1%</b>	<b>3.6</b>	<b>530</b>	<b>10.7%</b>
親会社株主に帰属する 当期純利益	971	▲7.4%	3.0	<b>1,000</b>	<b>2.9%</b>	<b>2.5</b>	<b>347</b>	<b>11.7%</b>
1株当たり配当金	105.0円	—	—	<b>110.0円</b>	—	—	—	—

# セグメント別業績予想

- 市場回復を背景に、販売事業・受託製造事業ともに増収を見込む
- 販売事業は堅調な受注を背景に大幅な増益  
受託製造事業は、増産・品質向上に向けた先行投資から減益を予想

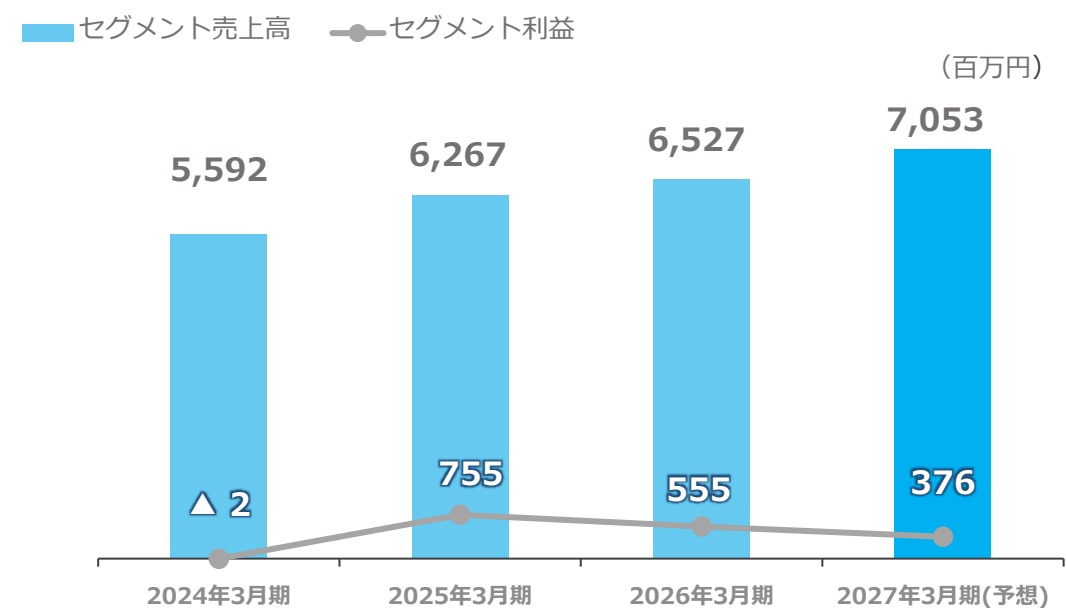
## 販売事業

- 生成AI需要の拡大を背景としたHBM・先端ロジック向け投資の回復に伴い、販売が拡大し、大幅な増収を見込む
- AI関連投資をはじめ、今後の成長を見据えた成長投資から費用は増加するも大幅な増益予想



## 受託製造事業

- 受注回復に伴う増産に加え、メンテナンスサポートにおけるフィールドエンジニアの増員により、増収を見込む
- 増産対応に向けた製造スペースの確保や人員体制の強化等の先行投資から減益を予想



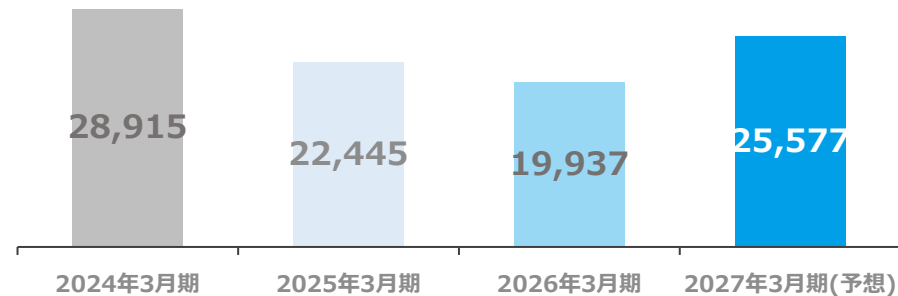
(注) セグメント売上高及びセグメント利益は、連結調整前の数値となっております

# 事業ポートフォリオ別売上高予想

- 「MIRAI 2030」に基づき、技術領域であるフィールド及びテクニカル・ソリューション事業を重点的に強化

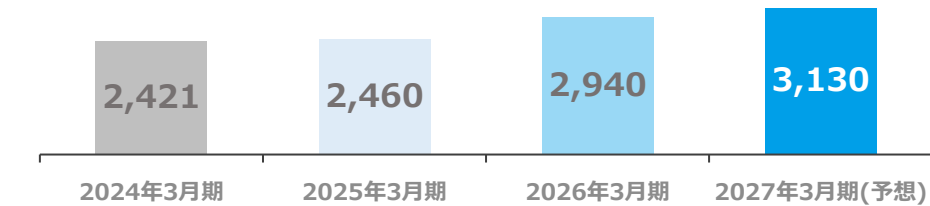
## サプライチェーン・ソリューション事業

(百万円)



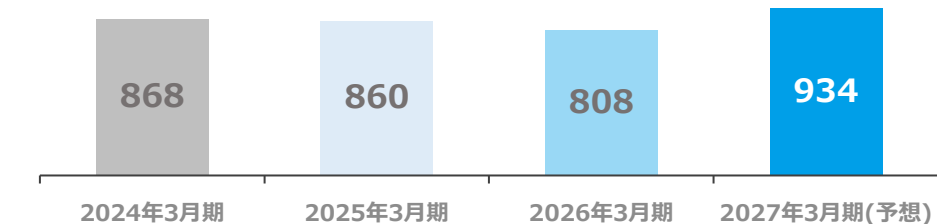
## フィールド・ソリューション事業

(百万円)



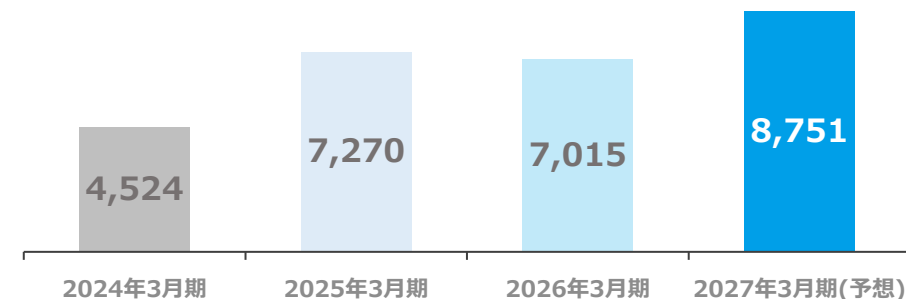
## テクニカル・ソリューション事業

(百万円)



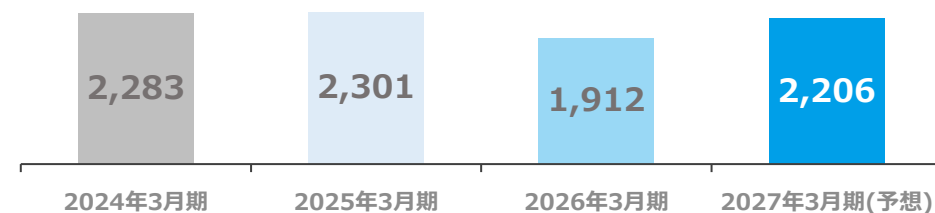
## マニュファクチャリング・ソリューション事業

(百万円)



## プレジジョンマシニング・ソリューション事業

(百万円)



# 配当政策

- ・ 今後の成長のための投資と株主様への還元のバランスを考慮しつつ、企業価値向上を目指す

## 基本方針

連結配当性向 **30%以上**

連結株主資本配当率  
(DOE) **3%以上**

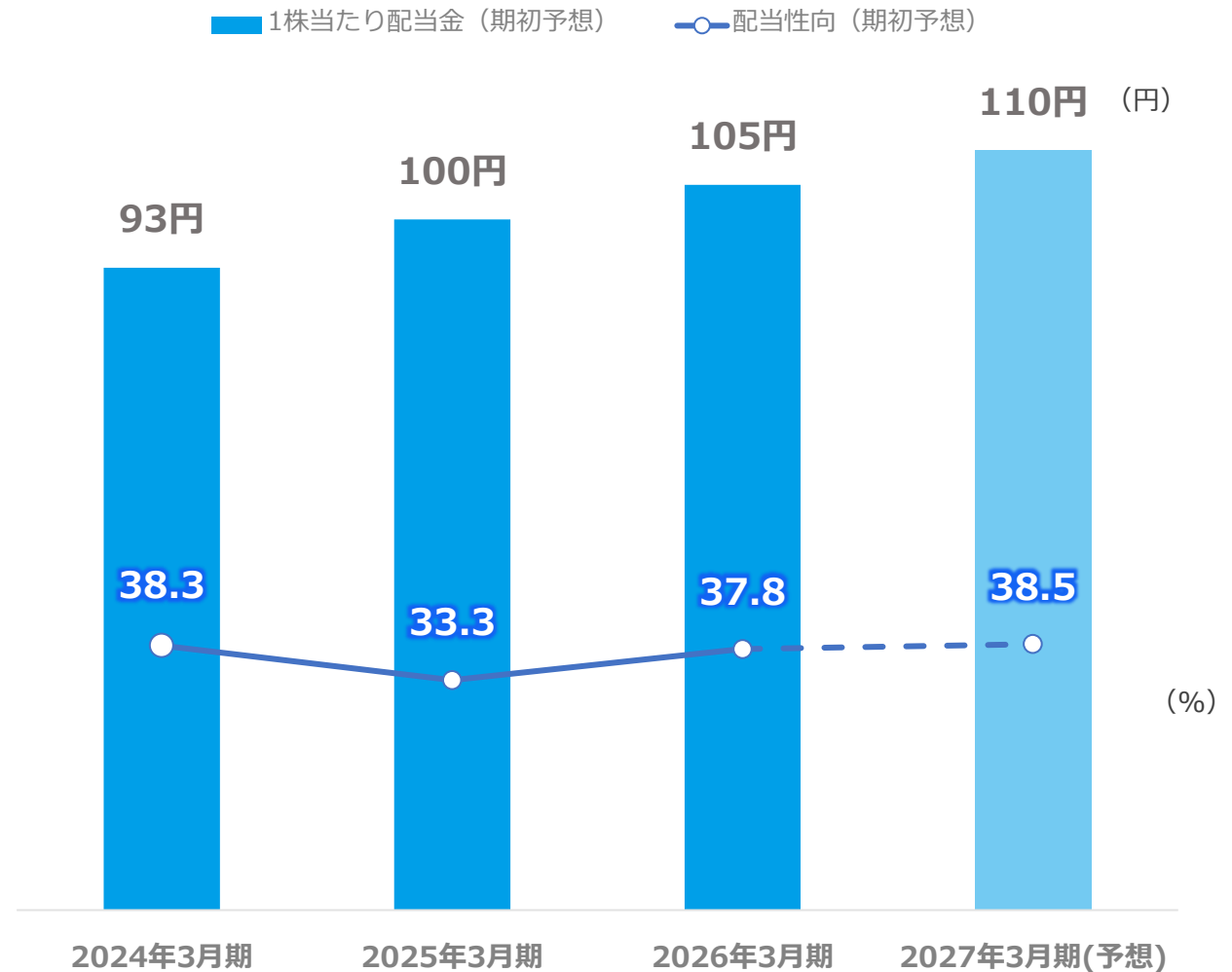


業績に応じた配当を継続していく

\* 2024年2月13日配当方針の変更

## 株主還元に係る当社の考え方

- ・ 中長期的な視点を持って継続的な企業価値向上により株主様へ還元してまいります
- ・ 今後のさらなる半導体市場の成長を確実にキャッチアップするため、新しい事業領域を含めたM & Aをはじめ、工場の新設等、今後も積極的に投資を行っていきたいと考えております



# サステナビリティ目標

## ・新中期経営計画「MIRAI 2030」の戦略に基づき新たに2項目追加

※ 評価：○ = 達成  
▲ = 未達成

ミッション	マテリアリティ	サステナビリティ目標	サステナビリティKPI	26.3期			27.3期	単位
				KPI目標	実績	評価	KPI目標	
Market creation : 新市場の創造	新市場創造戦略	未開拓市場（新市場・新製品）への進出、及び新成長戦略の事業化	開発製品（自社・共同開発）、及びAI関連事業の立上げ件数	0	1	○	3	件
Innovation : 技術革新	エンジニア	メンテナンスサポート分野の技術者増員と人材育成システムの強化、及びAI人材の育成	エンジニアの充足率	100.0	100.0	○	100.0	%
			AI人材数（累計）	—	—	—	50	人
Resilience : 変化への柔軟な対応	ガバナンス強化	社外取締役の比率、及び女性取締役の選任（提出会社） ビジネスモデル変革委員会の設置・運営	社外取締役の比率	34.0	37.5	○	34.0	%
	エンゲージメント向上	働きがい、働きやすさの向上と多様性の確保	女性取締役	1	1	○	1	人
			女性管理職比率	9.0	11.0	○	10.0	%
	環境対応	CO <sub>2</sub> 削減（2022年度対比） 再生可能エネルギーへの切替え	2030年目標70%減、 2040年NetZero	12.0	34.1	○	36.5	%
再エネルギー比率			—	—	—	30.0	%	
Alliance : サプライチェーンの連携	共同研究開発	他社との協議による新製品・新技術の研究開発 産学連携・スタートアップとの提携	共同開発による開発件数	3	4	○	4	件
Integration : 価値の統合	サプライチェーンと バリューチェーンの統合	サプライチェーン1,500社と、当社のバリューチェーンの 統合により、市場に新たな価値を提供 AI/SCMプラットフォームの構築	営業利益率	3.5	4.3	○	3.7	%
			サプライヤーAPI連携数	—	—	—	100	社
資本政策	資本コストを意識した 経営	企業価値向上 PBR 1倍以上の達成 ROE 12.5%の達成	PBR	≥1.0	0.63	▲	≥1.0	倍
			ROE	—	7.9	—	7.6	%
			DOE	—	3.0	—	≥3.0	%
Innovation : 技術革新	AI・DX推進	AI活用による業務効率化と新規事業の創出 フィジカルAI・AI/SCMシステムの事業化	AI関連売上高	—	—	—	1	百万円
			AI活用業務自動化率	—	—	—	20.0	%
Resilience : 変化への柔軟な対応	地政学・サプライ チェーンリスク対応	BCP体制の強化 サプライチェーンの冗長性確保 エネルギー調達が多角化	BCP訓練実施（回数）	—	—	—	2	回
			法規制対象品の調査回答率	—	—	—	60.0	%



## 参考資料

# 参考資料 会社概要

本社所在地	東京都世田谷区三軒茶屋
設立	1961年6月
事業内容	半導体製造装置の部品の仕入販売、 受託製造が2本柱
従業員数	連結 687名 (2026年3月末)
連結子会社	内外エレクトロニクス株式会社 納宜伽義機材 (上海) 商貿有限公司



本社・東京営業所

納宜伽義機材 (上海)  
商貿有限公司

仙台事業所

国内 **35** 拠点

- ❖ 内外テック **20** 拠点
- ❖ 内外エレクトロニクス **15** 拠点

海外 **2** 拠点

- ❖ 内外機材(上海) **2** 拠点



# 参考資料 当社グループの主力ビジネス

## 半導体製造工程概要



内外テック  
技術提案商社



内外エレクトロニクス  
受託製造メーカー



モノづくりができるメーカー商社

# 参考資料 事業ポートフォリオ概要

- ・ 資本の最適配分を目指し、事業ポートフォリオ管理を実施

## 事業ポートフォリオの概要

### 事業ポートフォリオ

#### SS事業

#### 事業ポートフォリオ 事業概要

- サプライチェーン・ソリューション事業（販売）
  - ・ 豊富なラインナップと幅広いサプライチェーンにおける市場ニーズ対応

#### MS事業

#### マニュファクチャリング・ソリューション事業（受託組立）

- ・ カスタマイズされた製品の組立て
- ・ 高度な技術力とスピードで顧客の特定ニーズに対応

#### FS事業

#### フィールド・ソリューション事業（メンテナンスサポート）

- ・ 製品の長期的な性能維持をサポート
- ・ 実績と経験に基づく信頼性の高いサービスの提供

#### TS事業

#### テクニカル・ソリューション事業（製品開発・技術開発）

- ・ 革新的な自社製品の開発
- ・ 設計段階から顧客ニーズに沿った最適な技術を提供

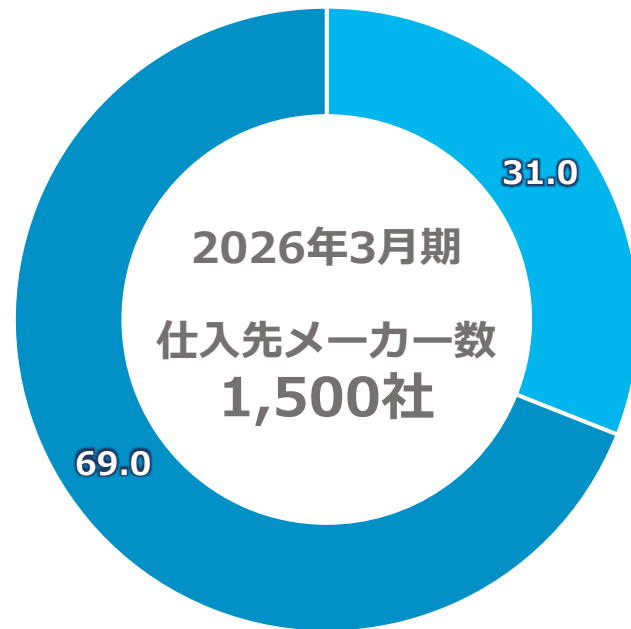
#### PS事業

#### プレジジョンマシニング・ソリューション事業（精密加工）

- ・ 精密部品の製造と加工
- ・ 高精密な加工技術と品質管理

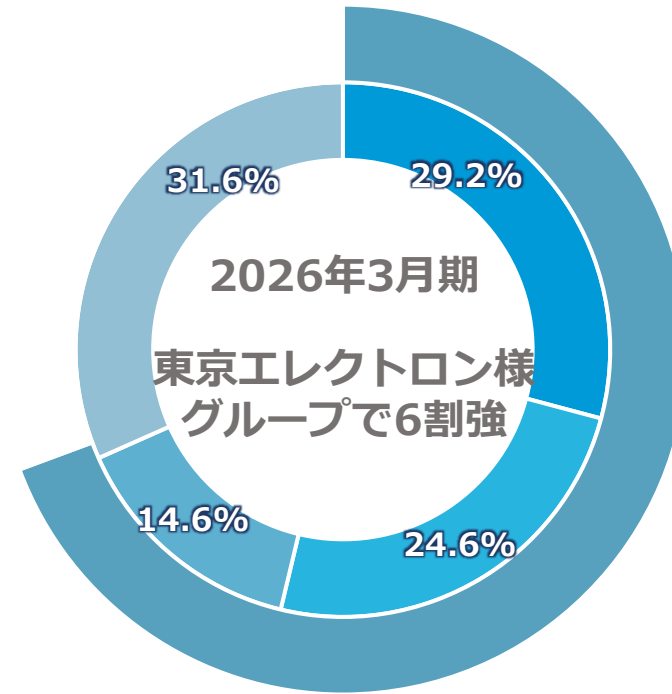
# 参考資料 当社の仕入先・販売先

## 仕入先



■ 空気圧機器メーカー ■ その他メーカー

## 販売先



■ 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社様  
 ■ 東京エレクトロン宮城株式会社様 ■ 半導体・液晶・電子部品各社  
 ■ 東京エレクトロン九州株式会社様

## 内外テック 仕入先・販売先

仕入先メーカー数	約 1,500件
得意先数	約 900件
年間取扱いアイテム	約 52,800件

主な取扱い商品サービス 空気圧機器、真空関連機器、機工部品、受託製造、メンテナンスサポート、装置改造

# NaigaiTEC Corporation

- 本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません
- 本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、その実現・達成を保証、約束するものではなく、また、その情報の正確性、完全性を保証、約束するものではありません
- 銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします

## 内外テック株式会社

<https://www.naigaitec.co.jp>

スタンダード : 3374